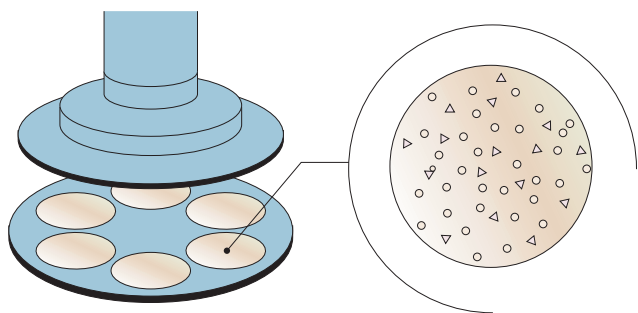


シリコンウェハのラッピング装置搭載
Measurement in silicon wafer thickness in a lapping machine

産業・工作機械業界 Industrial Machine



ベースセンサ P50 参照

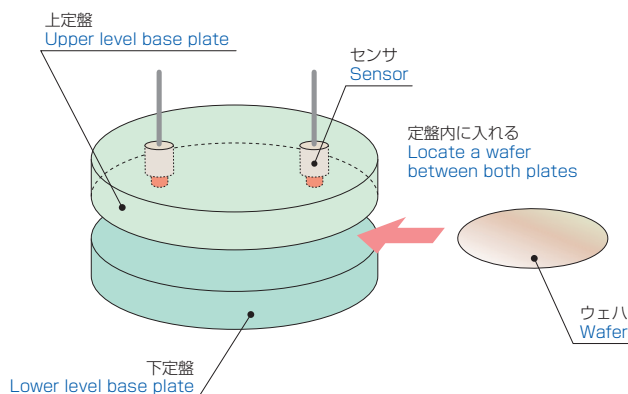
概要 General

スライスされたシリコンウェハの表面の粗さ及び、ある一定の厚みまで絞り込むために、ギャップセンサで± 3μm の精度で研磨するラッピングマシンに搭載されています。

To lap the sliced silicon wafer to a certain level of the surface roughness, the GAP-SENSOR is mounted to the lapping machine that laps the wafer with the accuracy of ± 3μm.

ウェハ厚さ測定
Measurement of wafer thickness

産業・工作機械業界 Industrial Machine



ベースセンサ P50 参照

概要 General

シリコンのインゴットからウェハに薄くスライスした材料の厚みを測定する時に使用しました。

上定盤と下定盤のギャップをセンサで捉えて、ウェハの厚みを割り出しています。センサは、05 コイルタイプが主流で、稀に09 コイルタイプも使用します。センサは上定盤に埋め込む方法で運用しました。

GAP-SENSOR is used to measure the thickness of the silicon wafer prepared by thinly slicing the silicon ingot.

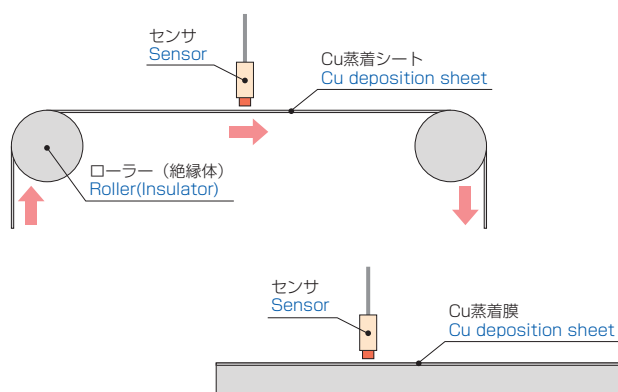
The sensor detects the clearance between the upper and lower level base plates to calculate the wafer thickness.

While 05 coil type sensors are mainly used, 09 type products are occasionally used also.

The sensors are embedded into the upper base plate.

Cu 蒸着膜シート測定
Cu Evaporated Film

産業・工作機械業界 Industrial Machine



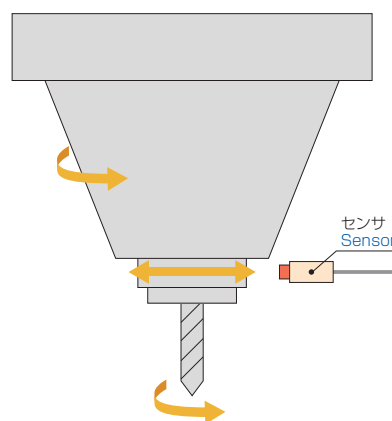
概要 General

Cu 蒸着膜の厚みを非接触で測定します。優れた耐環境性により、真空槽内で使用できます。

Measure thickness of Cu evaporated film by non-contact. Enable in vacuum chamber due to eminent environment resistance.

エンドミルの軸振動・回転数計測
Measure axis vibration・rotation of end-mil

産業・工作機械業界 Industrial Machine



ベースセンサ P49 参照

概要 General

エンドミルの軸振動・回転数を測定し、エンドミルの状態を監視します。耐油・耐水性に優れたセンサのため、水や油による測定の影響を受けません。

Monitor end-mil condition by measuring axis vibration・rotation of end-mil.

There is no influence for measurement by water and oil due to eminent oil and water resistance sensor.